

## Kooperations-Partner

Wir danken folgenden Kooperations-Partnern für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit:



### Key Note Frank Schätzing

Ein Programm-Highlight am 19. März 2019 stellt der Vortrag von Bestseller-Autor Frank Schätzing (Der Schwarm, Limit, Die Tyrannei des Schmetterlings) dar. Es erwartet Sie eine spannende Präsentation, in der die Zukunft mit künstlicher Intelligenz im Zeitalter der digitalen Revolution skizziert wird.

Zudem laden wir Sie recht herzlich zu unserer Abendveranstaltung am 19. März 2019 ein. Wir würden uns freuen, Sie auch hier begrüßen zu dürfen.



## Anmeldeinformationen

### Teilnahmegebühren:

EUR 150,- zzgl. MwSt. für Mitglieder der PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO)\*  
EUR 250,- zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder

### Leistungen:

Teilnahme an allen Vorträgen an beiden Konferenztagen, Pausen-Verpflegung,  
Teilnahme an der Abendveranstaltung.

### Veranstaltungstage:

Dienstag, 19. März 2019  
Mittwoch, 20. März 2019

### Veranstaltungsort:

House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH  
Bessie-Coleman-Straße 7 | 60549 Frankfurt am Main / Gateway Gardens  
www.frankfurt-holm.de

### Übernachtungsmöglichkeiten:

Für die Veranstaltung wurde ein Zimmerkontingent reserviert. Informationen hierzu finden Sie unter: [www.pi-konferenz.de](http://www.pi-konferenz.de)

### Anmeldung:

Bitte registrieren Sie sich bis spätestens **6. März 2019** online unter [www.pi-konferenz.de](http://www.pi-konferenz.de). Ihre Anmeldung wird per E-Mail bestätigt.

### Anmeldebedingungen

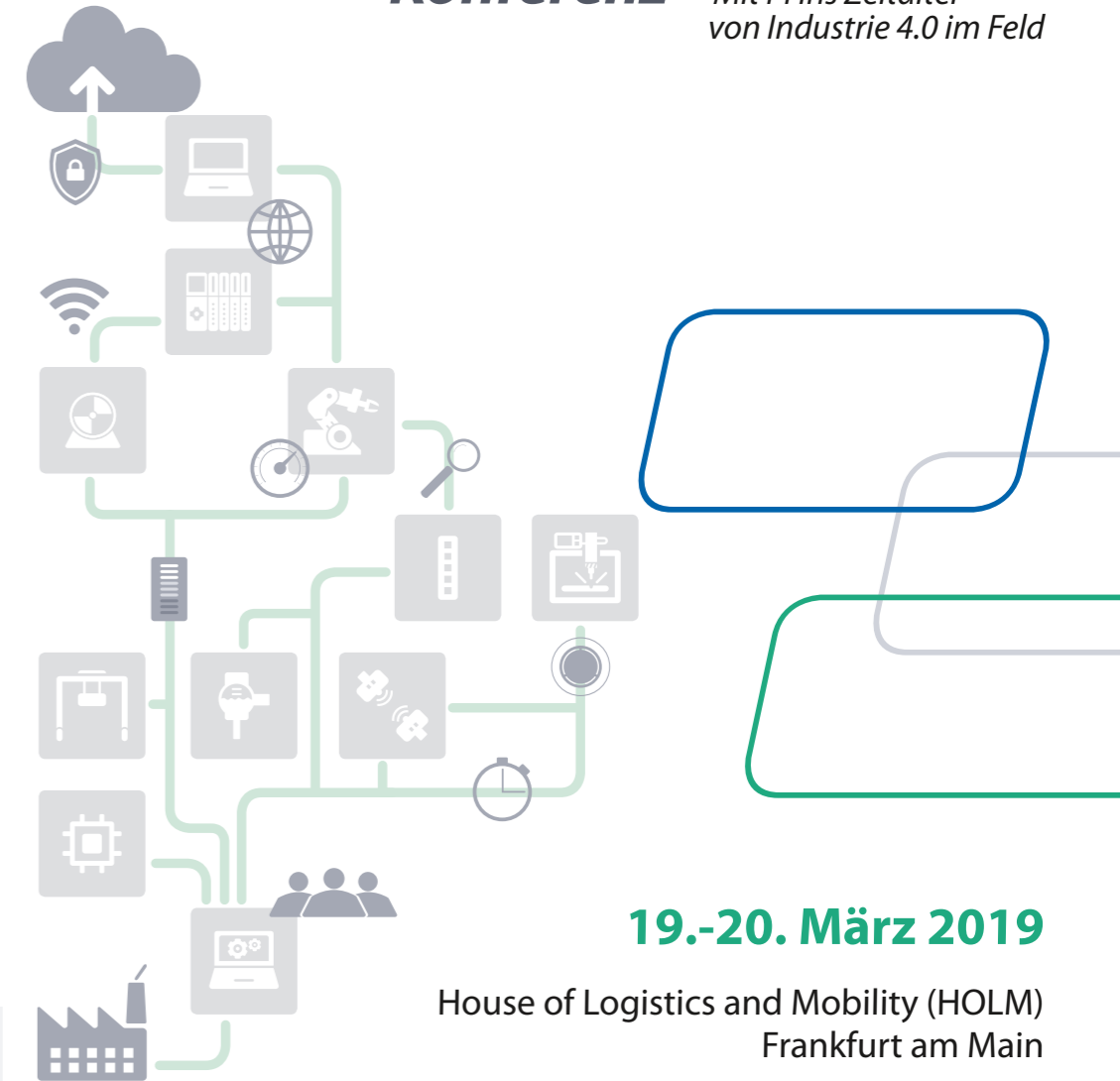
Anmeldungen zur PI-Konferenz werden nur online unter [www.pi-konferenz.de](http://www.pi-konferenz.de) akzeptiert. Bei Überbuchung entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr ist vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Im Falle einer Stornierung (nur schriftlich) bis 8. März 2019 wird Ihnen die Teilnahmegebühr erstattet. Nach der Veranstaltung bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers ist keine Erstattung möglich. Selbstverständlich kann vorab schriftlich ein Vertreter benannt werden. Bei zu geringer Teilnehmerzahl wird die Veranstaltung abgesagt und die Teilnahmegebühr erstattet. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Programmänderungen bleiben vorbehalten.

\* oder Mitglieder der PROFIBUS & PROFINET International (PI)

PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO)  
PROFIBUS & PROFINET International (PI)  
Haid-und-Neu-Str. 7 · 76131 Karlsruhe  
Tel.: +49 721 96 58 590 · Fax: +49 721 96 58 589  
E-Mail: [info@profibus.com](mailto:info@profibus.com)  
[www.profibus.com](http://www.profibus.com) · [www.profinet.com](http://www.profinet.com)

# PI 2019 Konferenz

Mit PI ins Zeitalter  
von Industrie 4.0 im Feld



**19.-20. März 2019**

House of Logistics and Mobility (HOLM)  
Frankfurt am Main

Key Note  
Frank Schätzing



Prof. Dr. F. Klasen |  
Vorstand PROFIBUS  
Nutzerorganisation  
e.V. (PNO) |  
Vorsitzender des  
Programmkomitees

„Mit PI ins Zeitalter von Industrie 4.0 im Feld“ – unter diesem Motto stellt sich die PI-Konferenz 2019 neu auf. Denn mit den Hauptthemen Semantik & Informationsmodelle, Kommunikation, Security sowie neue Geschäftsmodelle sollen nicht nur die Nutzer und Anwender der PI-Technologien – vom Entscheider bis zum Spezialisten – angesprochen werden. Vielmehr sind alle Interessierten der Digitalisierung im industriellen Umfeld zu diesem Community-Treff eingeladen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt bei den Technologietrends mit Bezug auf Industrie 4.0, Zukunftsstrategien und Herausforderungen im Umfeld des „Industrial Internet of Things“. Essenzielle Themen sind die Integration von TSN und OPC UA in PROFINET, Festlegung von weiteren Security-Maßnahmen sowie Definition und Abstimmung von Semantik-Aspekten in Kooperation mit anderen Organisationen, wie OPC Foundation und eCl@ss.

Es erwarten Sie Vorträge zu aktuellen Entwicklungen und Trends, Technik im Detail sowie konkrete Anwendungsbeispiele.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

## Programm Tag 1 | Dienstag, 19. März 2019

Änderungen vorbehalten!

### Plenumsvorträge

13:30	<b>Begrüßung</b> K. Schneider, PNO / PI
13:45	<b>Big Picture – PI-Technologien heute und morgen</b> Vorstand, PNO / PI   X. Schmidt, Industrie 4.0 WG
15:00	<b>Pause   Microfair</b>
15:30	<b>PROFINET und OPC UA – Die optimale Kombination</b> M. Damm, Ascolab   K. Schneider, PNO / PI
16:00	<b>Semantik – Von Daten zu Informationen</b> Prof. C. Diedrich, ifak   T. Kroke, eCl@ss
16:30	<b>Wem gehören die Daten? Rechtsfragen zu Industrie 4.0</b> Prof. T. Riehm, Universität Passau
17:00	<b>Pause   Microfair</b>
17:15	<b>Key Note</b> <b>Von Schmetterlingen und Tyrannen</b> <b>Ausblicke in eine Zukunft mit Künstlicher Intelligenz</b> F. Schätzing, Bestseller-Autor (Der Schwarm, Limit, Die Tyrannei des Schmetterlings)
18:30	<b>Abendveranstaltung inkl. Abendessen</b>

## Programm Tag 2 | Mittwoch, 20. März 2019

Änderungen vorbehalten!

### Parallele Vorträge | Aktuelle Entwicklungen, Trends und Beispiele

09:00	<b>Warum PROFINET mit TSN?</b> Mod.: J. Krautter, Murrelektronik • TSN-Anforderungen T. Kompa, VW • Herausforderungen in der modularen Fabrik H. Krattenmacher, SEW • PROFINET@I4.0 – Der Migrationspfad J. Krautter, Murrelektronik	<b>Security-Herausforderungen in der Automation</b> Mod.: S. Heidepriem, Sick • IEC 62443 – Industrial Security braucht Standards S. Heidepriem, Sick • Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) N. N. • Das PROFINET Security-Konzept Prof. Dr. K.-H. Niemann, Hochschule Hannover
10:30	<b>Pause   Microfair</b>	<b>Industrie 4.0 Informationsmodelle</b> Mod.: M. Prinzen, Festo • Industrie 4.0 – Verwaltungsschale am Beispiel FDI F. Fengler, ABB   M. Hoffmeister, Festo • Applikationsdiagnose G. Leßmann, Phoenix Contact • OPC UA Companion Spezifikationen im VDMA am Beispiel von Antriebssystemen M. Hegmann, Siemens
11:00	<b>Netzwerkarchitektur der Zukunft</b> Mod.: M. Müller, Phoenix Contact • JWG IEC/IEEE 60802: Konvergentes Netzwerk L. Winkel, L.A.N. Winkel Consulting • Wandel in der Zellenintegration S. Gottwald, Siemens • Datenverarbeitung und Cloud Connectivity H.-J. Hilscher, Hilscher	<b>PROFINET in der Prozessautomatisierung</b> Mod.: H. Fiesel, Endress+Hauser • PROFINET Lösungsplattform für die Prozessautomation K. Büttner, Endress+Hauser   J. Czech, Siemens • Namur Open Architecture J. de Caigny, BASF • FDI Innovationen – Semantik und HTML5 M. Maurmaier, Siemens • Ethernet – Advanced Physical Layer Dr. J. Hähnliche, Endress+Hauser
12:30	<b>Pause   Microfair</b>	<b>Industrie 4.0 am Beispiel</b> Mod.: D. Vielsäcker, Siemens • LNI 4.0 Testbeds validieren Standardisierung Dr. D. Rohrmus, Labs Network Industrie 4.0 e.V. • Verwaltungsschale konkret A. Pühringer, SAP • OPC UA Anwendungen bei AUDI M. Mayer, AUDI
13:30	<b>Industrie 4.0 Informationsmodelle</b> Mod.: M. Prinzen, Festo • Industrie 4.0 – Verwaltungsschale am Beispiel FDI F. Fengler, ABB   M. Hoffmeister, Festo • Applikationsdiagnose G. Leßmann, Phoenix Contact • OPC UA Companion Spezifikationen im VDMA am Beispiel von Antriebssystemen M. Hegmann, Siemens	<b>Neue Technologiefelder</b> Mod.: H. Krattenmacher, SEW • Autonome Systeme und Robotik K. Petersen, Mitsubishi • Big Data – Anomalie-Erkennung in Netzwerken Dr. E. Costante, SecurityMatters • ACIA Initiative ZVEI A. Bentkus, ZVEI
15:00	<b>Pause   Microfair</b>	<b>Industrie 4.0 im Beispiel</b> Mod.: A. Laubenstein, ABB • Industrie 4.0 Nutzen von Feldgerätedaten in der Cloud S. Ochsenreither, Endress+Hauser • Nutzung von Smart-Sensor-Daten ohne zusätzliche OT-Netzwerkbelastung R. Heidl, Indu-Sol   Dr. M. Todtermuschke, Fraunhofer IWU • IIoT wireless Anwendungen T. Schildknecht, Schildknecht
17:00	<b>Ausklang der Veranstaltung   Microfair</b>	

## Programm Tag 2 | Mittwoch, 20. März 2019

Änderungen vorbehalten!

### Parallele Vorträge | Technik im Detail

09:00	<b>TSN im Detail</b> Mod.: G. Leßmann, Phoenix Contact • TSN Basics, Engineering G. Steindl, Siemens   G. Leßmann, Phoenix Contact • Bits und Bytes von PROFINET mit TSN G. Steindl, Siemens   G. Leßmann, Phoenix Contact • Feldgeräte-Architektur mit TSN V. Goller, Analog Devices	<b>Security-Erweiterungen für PROFINET</b> Mod.: Prof. Dr. F. Klasen, PNO / PI • Technische Anforderungen D. Gebert, Siemens • Lösungskonzepte O. Pfaff, Siemens • Einblicke aus der Perspektive von Betreibern, Herstellern und der PNO A. Walz, Hochschule Offenburg
10:30	<b>Pause   Microfair</b>	<b>IO-Link Innovationen</b> Mod.: E. Büchler, Balluff • IO-Link Wireless Dr. R. Heynicke, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg • Smart Sensor Profil aus Anwendersicht W. Wiedemann, Murrelektronik   M. Walther, ifm • IO-Link Safety sorgt für Digitalisierung Dr. W. Stripf, ACS • IO-Link Integration mit PROFINET und OPC UA M. Tiegelkamp, TE Connectivity   K.-P. Willems, TMG
11:00	<b>PROFINET und OPC UA</b> Mod.: C. Behler, Mitsubishi • Controller-Controller Kommunikation mit OPC UA M. Schlittenbauer, Siemens • Anlagenübergreifendes Safety mit OPC UA based on PROFIsafe Dr. M. Walter, Siemens • Mapping von PROFINET auf OPC UA Dr. A. Uhl, Siemens   T. Rummel, Softing	<b>APL erklärt</b> Mod.: A. Hennecke, Pepperl+Fuchs • Das APL Projekt S. Lüder, Siemens • Phase 1: 10 Mbit Technologie G. Rogoll, Pepperl+Fuchs • Phase 2: 100 Mbit Technologie H. Müller, Endress+Hauser
12:30	<b>Pause   Microfair</b>	<b>Semantik und Profile</b> Mod.: H. Hammon, Siemens • PA Profil – Herstellerübergreifender Gerätetausch H. Flämig, Siemens • Vom PI Applikationsprofil zum selbst beschreibenden Informationsmodell H. Hammon, Siemens • Das Semantik Konzept von NOA Prof. D. Grossmann, Technische Hochschule Ingolstadt   F. Fengler, ABB
13:30	<b>Wireless für PROFINET</b> Mod.: Dr. J. Hähnliche, Endress+Hauser • Wireless im Überblick in FA und PA F. Hakemayer, Phoenix Contact   Dr. W. Thoren, Endress+Hauser • Möglichkeiten und Herausforderungen bei 5G J. Eichinger, Huawei • 5G – Das Funknetz in der Fabrik N. N.	<b>Stecker Innovationen</b> Mod.: A. Huhmann, Harting • M12 L A. Huhmann, Harting • Push Pull M12 A. Huhmann, Harting • Single Pair Ethernet in der Connected World S. Seereiner, Weidmüller
15:00	<b>Pause   Microfair</b>	
17:00	<b>Ausklang der Veranstaltung   Microfair</b>	